

2200℃ 진공 및 청정환경 지르코니아 접착제 : Resbond™ 904

전자, 야금 및 구조 응용 분야용



지르코니아 1액형 접착제

부드럽고 크림 같은 페이스트로 쉽게 바르고 상온에서 건조하여 단단한 표면을 형성합니다.

금속용탕에 견디고, 대부분의 화학물질 및 용제, 산화 및 환원 분위기에 대한 강항 내성을 지닙니다.

1870℃ 진공(Vaccum)에서 사용되고 열-그레이비 구조 (Thermogravymetric) 분석기의 챔버에 배기 라인을 부착(본딩)하는데 사용됩니다.



세라믹 어셈블리에 센서 접착

■ 접착물질

카본	알루 미늄	스테인 레스	금속	세라믹	유리	플라 스틱	복합 소재
0	0	0	0	0	0		0

■ 사용자 보고서

- : 반도체 청정실에서 사용되는 1427℃ 퍼네이스 튜브에 실리카 테이프를 붙이는데 사용
- : 그라파이트(흑연)도가니에 코팅함으로서 아연용탕으로부터 도가니를 보호
- : 우주비행선 알루미늄판을 코팅함으로서 X-ray 복사열로부터 알루미늄 플레이트를 보호
- : 초 고온 내화학 산화 방지 용도. 즉, 고온벽돌 열면 코팅, 절열포팅, 써모카플 보호, 용접, 납땜 관련 사양에 널리 사용
- : 세라믹, 흑연 및 써모카플 튜브용 전기, 산화 침식 및 액체 금속 저항성 코팅을 결합하고 형성하는데 이상적

용접, 블레이징, 본딩, 전기 씰링, 열전대 보호, 장비, 고온/벽돌용 페이싱, 전기 포팅, 액체 금속 취급

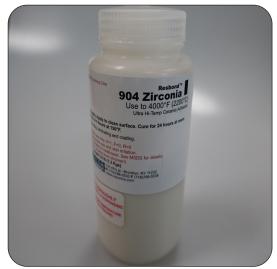
구 분	904
최대온도(°C) - Maximum Temperature	2,200
구성/색상 - Component/Color	1 / 황갈색
순도(%) - ixed Density	95
농도 - Consistency	Paint
압축강도(psi) - Compressive Strength	6,000
열전도(BTU-in/Hr. Ft²°F) - Thermal Conductivity	10
열팽창(10 ⁻⁶ /°F) - Thermal Expansion	4.10
유전력(volts/mil.) - Dielectric Strength	250
경화(hrs@R/T)	24

■ 사용방법

1액형 접착제라서 사용전에 잘 섞어주고, 도포 할 표면을 깨끗이 한 후 가정용 페이트를 칠하듯이 도포하시면 됩니다. 상온에서 24시간을 건조 시키든지, 70℃에서 4시간 정도 열경화 하시면 됩니다.

■ 판매단위

904: Pint / Quarter



904-1 (Pint) 제품